

DUROCK® CEMENT BOARD

듀락 시멘트 보드

USG의 첨단 기술로 개발된 세계에서 가장 가벼운 시멘트 보드인 듀락(Durock® cement board)은 골재가 함유된 시멘트 코어에 유리 섬유 메쉬가 보드의 양면에 매립된 제품입니다. 우수한 타일 부착력과 습윤시에도 강성이 저하되지 않는 내구성을 지닌 듀락은 건축물 내장 및 외장재로 겸용이 가능한 자재입니다.



균일한 평활도

1/2" 두께로 외벽 마감에 최적의 평활도를 제공하며, 메쉬가 매립 되어있어 크랙에 대한 저항성이 뛰어납니다.



탁월한 시공성

USG의 기술로 초경량 콘크리트 입자가 적용된 경량의 시멘트 보드는 자재 운반이 쉽고, 커터칼로 절단이 가능해 시공이 용이합니다.



우수한 유연성

매립된 유리 섬유 메쉬는 보드의 유연성을 증가시켜 곡면 시공이 가능하여 다양한 건축 디자인 구현을 가능하게 합니다.



친환경성

ASTM D3273 항곰팡이 테스트에서 최우수 등급인 10점 획득으로 곰팡이가 발생하지 않으며, 석면이 함유되지 않은 친환경 시멘트 보드입니다.



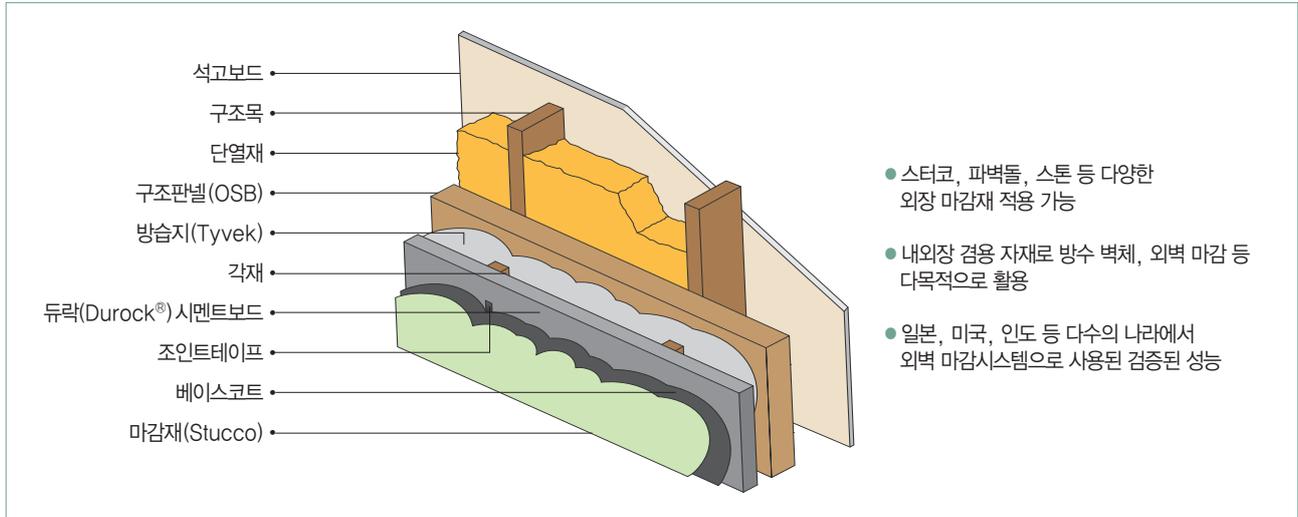
불연재

화재에 취약한 목조 자재와 달리 불연재로서 외부의 화재로부터 건물을 보호합니다.

한국 유에스지 보랄(주)

서울시 강남구 테헤란로 87길 36(삼성동) 도심공향타워빌딩 7층 TEL : (02)6902-3100, FAX : (02)6902-3190

목조주택 외벽 마감 시스템



제품 포장 단위 및 물성

두께(mm)	규격(mm)	포장단위	모서리(엣지) 형태
12.7 (1/2")	1220 X 2440	40매 / 팔레트	라운드

항목	단위	규격 (ASTM)	듀락
단위면적당 질량	kg/m ²	-	11.72
열전도율	W/mK	-	0.16
굴곡강도	kg/cm ²	C947	52.73
표면강도	kg/cm ²	D2394	87.88
흡수율	%	C473	15
불연성	-	E136	불연재
곰팡이 저항성	-	G21	성장없음(최고점)
최소 곡률 반경	cm	-	183

제품 특징

시멘트 보드의 강성을 유지한채 곡면 시공이 가능하여, 다양한 건축물 디자인에 적용 가능

